

Jetzt anmelden:

epp.industrie.de/

innovationsforum-deutschland-2023

Vorträge live vor Ort!



EPP

**Innovations
FORUM**

Deutschland

11. EPP InnovationsFORUM Deutschland

Wettbewerbsfähige Elektronikfertigung

in Deutschland

29. Juni 2023

9:00 bis 16:30 Uhr

Filderhalle Leinfelden

Das EPP InnovationsFORUM ist die führende, unabhängige Veranstaltung im Bereich Fertigung elektronischer Baugruppen.

Schwerpunktthemen der Veranstaltung sind:

- Nachhaltig. Energieeffizient. Ressourcenschonend
- Verkürzte Lieferketten durch Reshoring
- Digital. Vernetzt. Smart
- Smarte Produktion ermöglichen
- Daten im Zeitalter der Digitalisierung

**Jetzt
anmelden!**

**Ihr
Promo-Code**

REHM23IFD

Unsere
Premium-Partner:



Unterstützender
Partner:



Unsere
Basis-Partner:



	Panoramasaal	Kleiner Saal
Ab 8:00 Uhr	Registrierung	
09:00 - 09:10 Uhr	Begrüßung: Doris Jetter, <i>Chefredakteurin EPP / EPP Europe</i>	
09:10 - 10:10 Uhr	Keynote: Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Gesellschaft Prof. Dr. Wolfgang Ertel <i>Institut für Künstliche Intelligenz, Hochschule Ravensburg-Weingarten</i>	
10:10 - 10:40 Uhr	Secondary First! Vom Abfall zum Wertstoff Lothar Pietrzak <i>Senior Consultant MTM Ruhrzinn GmbH</i>	Mitarbeiter effizienter einsetzen - Wettbewerbsfähige Elektronikfertigung in Zeiten des Fachkräftemangels Oliver Hagemes <i>Technischer Vertrieb Schnaidt GmbH</i>
10:40 - 11:10 Uhr	Kaffeepause Networking	
11:10 - 11:40 Uhr	Schablonendruck auf dem Weg in die dritte Dimension Frank Breer <i>Key Account- & Business Development Manager Christian Koenen GmbH</i>	Viscom AI Solution - The Next Level of Effective Inspection Processes Thomas Winkel <i>Vertrieb Europa Viscom AG</i>
11:40 - 12:10 Uhr	High-End Lötendraht - der Garant für zuverlässiges automatisiertes Löten Michael Mendel <i>Geschäftsführer ALMIT GmbH</i>	Servitization - Vom Produkt- zum Lösungsanbieter Christian Rückert <i>Bereich Anwendungstechnologie</i> Jörg Nolte <i>Chief Innovation Manager Ersa GmbH</i>
12:10 - 12:40 Uhr	Alkoholbasierte Flussmittel: Alternativen und Maschinenteknik in Wellen- und Selektiv-Lötprozessen Dr. Ronny Horn <i>Key Account Manager SEHO Systems GmbH</i>	Smarte Bedienerführung steigert Effizienz und Zufriedenheit der Bediener in der Elektronikfertigung Thomas Marktscheffel <i>Director Product Management Software Solutions ASMPT GmbH & Co.KG</i>
12:40 - 14:00 Uhr	Mittagessen Lunch	
14:00 - 14:30 Uhr	Energieeffizientes Reflow Löten durch weiterentwickelte Lot-Werkstoffe Andreas Karch <i>Technologie - Neue Anwendungen Technischer Manager Indium Corporation of America</i>	Flexibles und hochautomatisiertes Laser-Nutzentrennen Patrick Stockbrügger <i>Produktmanager LPKF Laser & Electronics AG</i>
14:30 - 15:00 Uhr	Dampfphasenlöten - One For All Dr. Paul Wild <i>Leiter Forschung & Entwicklung Rehm Thermal Systems GmbH</i>	Neue Dimensionen in der Elektronikfertigung Harald Eppinger <i>Managing Director Koh Young Europe GmbH</i>
15:00 - 15:30 Uhr	Kaffeepause Networking	
15:30 - 16:00 Uhr	Umweltfreundliche und effiziente Baugruppenreinigung Martin Mattes <i>Senior Prozessingenieur ZESTRON Europe... a Business Division of Dr. O.K. Wack Chemie GmbH</i>	Flying-Probe-Technologie und Innovation in der Elektronikfertigung: Wie Seica bei der Bewältigung von Herausforderungen in einer sich schnell verändernden Welt und Produktionsumfeld unterstützt! Thomas Hirschfeld <i>Area Sales Manager Seica</i> Henrik Brüggling <i>Area Sales Manager Seica</i>
16:00 - 16:30 Uhr	Neuentwicklungen bei Gießharzen: Silikon, Polyurethan- und Epoxy-Systeme mit hohen Temperaturen und hoher Wärmeleitfähigkeit Jens Bürger <i>Technical Sales Manager ELANTAS Europe GmbH</i>	Artificial Intelligence for AOI - The International Electronics Manufacturing Initiative (iNEMI) Wolfgang Heinecke <i>Head of Product Management Mycronic AB</i>
ab 16:30 Uhr	Verabschiedung	